华进半导体封装先导技术研发中心有限公司年封装测试2500万颗半导体产品的先进封装与系统集成升级改造项目（第一阶段）

环境保护设施竣工日期和调试时间信息公开

根据《建设项目竣工环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评［2017］4号）等文件相关规定，现将华进半导体封装先导技术研发中心有限公司年封装测试2500万颗半导体产品的先进封装与系统集成升级改造项目（第一阶段）的环境保护设施竣工日期及调试日期进行公示如下：

项目名称：年封装测试2500万颗半导体产品的先进封装与系统集成升级改造项目（第一阶段）

建设单位：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

建设地址：无锡市新吴区运河西路以西，景贤路以北

项目及配套建设的环境保护设施竣工日期：2022年12月25日

调试日期：2023年1月1日~2023年3月31日

我公司承诺对上述公开的信息真实性负责，并承担由此产生的一切责任。

 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

2023年1月1日